

超低硬度複合放熱シリコンパッド

Thermal Interface Silicone Ultra Soft Laminated Pads

New

TC-100CABC-5, TC-100CADC-5

独自のポリマー技術とフィラー配合技術により
高い熱伝導率と電気絶縁性を両立しました
さらに片面非粘着層の構造を持ち合わせた
超低硬度複合放熱シリコンパッドです

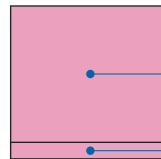
These products are thermal interface silicone ultra soft laminated pad which have high thermal conductivity and excellent electrical insulation properties, and one-side adhesive layer which stem from Shin-Etsu's advanced polymer and thermally conductive filler composite material technologies.

特長 | Features

- 超低硬度層の密着性と高硬度層の非粘着性を合わせ持ち、優れた放熱性と作業性を両立
- 高熱伝導率と優れた電気絶縁性を実現
- 超低硬度層は圧縮特性と応力緩和に優れ、電子デバイスへのストレスを低減
- Achieving both low thermal resistance and workability with different sticky surface and hardness.
- High thermal conductivity and excellent insulation properties.
- Ultra-low-hardness layer that makes for good compressibility and a stress-relaxation property that can reduce stress to electric devices.

構造 | Structure

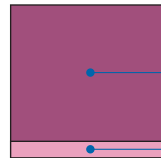
TC-100CABC-5



超低硬度層 (0.9mm)
Ultra soft pad layer

高硬度層 (0.1mm)
Hard sheet layer

TC-100CADC-5



超低硬度層 (0.9mm)
Ultra soft pad layer

高硬度層 (0.1mm)
Hard sheet layer

用途 | Applications

電気自動車、ハイブリッド自動車、電源、LED照明、PCなど

EV, HV, Power Supply, LED Lighting, PCs

一般特性 | General Properties

項目 Parameter	TC-100CABC-5	TC-100CADC-5
色 color	淡赤褐色/淡赤褐色 Light reddish brown/ Light reddish brown	淡紫色/淡赤褐色 Light reddish purple / Light reddish brown
標準シートサイズ Sheet size	300x400	300x400
構造 Structure	複合 Composite	複合 Composite
密度 Density 23°C	2.2	3.0
硬さ アスカー-C Hardness Asker C *1	5	5
絶縁破壊電圧 Dielectric Breakdown Voltage	22	15
熱伝導率 Thermal Conductivity *1,*2	2.3	3.2
難燃性 Flammability UL94	V-0相当 V-0 equivalent	V-0
厚さ Thickness	1.0	1.0

*1 低硬度層の値 Value of soft pad layer

*2 ISO 22007-2準拠 Based on ISO 22007-2

(規格値ではありません Not specified values)